

株式会社アドバンテスト

第2期中期経営計画(FY2021-FY2023)説明会 質疑応答要旨

2021年5月24日(月)

- Q: テスタ市場の見通しに関して、今後、前工程並みの成長が期待できる可能性があると言及された。仮に今後、テスタ市場が前工程と同様に2年間で30%程度成長した場合、営業利益やROEはどの程度となる見通しか。
- A: 半導体の前工程装置とテスタの需要は必ずしも同期していない。例えば過去3年においてはテスタ市場の伸びの方が前工程装置よりも大きかったと考えている。一方で前工程装置のリードタイムには1年以上のものもあり、足元の前工程の大型投資の影響は、ある程度の時間をかけつつテスタ市場に遅れて波及してくるとみている。
- 今回、売上高3,500~3,800億円という売上計画を示したが、今の前工程投資計画の規模感であれば、中計後半の年度に当社が売上高4,000億円に到達してもおかしくはないと思っている。その場合、当該年度のROEやEPSはもちろん伸びていく。ただし単年度ではなく3年平均の数字で見ているため、利益成長率に関しても、売上高で示したレンジに沿った範囲を現状では想定している。
- Q: 新中計ではシステムレベル・テスト(SLT)を含む新規事業について、350~400億円の売上見通しを示している。以前示していた年成長率20~30%程度という期待と比べると、物足りない印象。SLTの事業環境や受注、今後の見通しについて補足があれば教えてほしい。
- A: SLT分野で実施した2件のM&Aは、顧客基盤が限られていた事業を買い取り、それを我々の顧客へソリューション展開することで事業拡大を図っている。ただし、顧客拡大には1社ごとの個別対応を必要とすることから、当初計画よりも少しスローな状況にあるが、従前示した成長率を今後実現できる期待は依然ある。半導体の高性能化を背景に、SLTに関しては今後3年間の成長可能性に高い期待を持っている。
- Q: 今後のテスタ市場に関して、過去よりもシクリカリティが小さくなるという見方を示しているが、その背景にはどのような市場変化があるのか。
- A: ITバブルやリーマンショックなど経済危機による大きな波、そしてその間のパソコンやガラケーなど最終製品の販売動向による波によって、半導体生産量は変動し、当社のテスタ売上も過去上下を繰り返してきた。しかし2017年以降は、他のSPEと変わらないくらいに当社売上の変動は落ち着いてきている。その大きな理由は、半導体を使うアプリケーションの裾野が広がったこと。1つのアプリケーションの需要アップダウンだけでテスタ需要の消長が決まるのではなく、色々な産業の半導体需要が複合的に集積するようになったことで、テスタ需要の波が小さくなっている実感がある。波がなくなるとは言えないが、今後テスタ市場はLess-Cyclicalになっていくと見込んでいる。

Q: リカーリング売上増加やデータ・アナリティクス事業の拡大も、御社の業績ボラティリティを低減させることに寄与してくるのではないかと。

A: 当社は「AT Cloud ソリューション」というデータ・アナリティクス・サービスをローンチしているが、その収益化には少し時間がかかると思っている。当社が目指しているのは、当社顧客にとって価値の高い、半導体の製造、歩留まり向上、Time to Quality、Time to Volume に貢献できるソリューションの提供。現状、世界の一流インベーターでもある顧客の力を借りつつ、ソフトウェアとハード(テスト)を融合したソリューションの提供を構想しているが、ここ数年は先行投資の方が多くなる見通し。収益化の目途について話ができるのは、18 カ月後、24 カ月後くらいを想定していただきたい。

Q: ミリ波のテスト市場は、いつ頃から本格的に立ち上がる見通しか。また、ミリ波のテスト需要はどのくらいの規模になると想定しているか。

A: 当社は今まさに、ミリ波に対するテスト技術を顧客とともに開発中。需要本格化は 2022 年後半以降とみている。今年が技術検証フェーズであるが、来年後半からいろいろなデバイスが立ち上がり、22 年後半から 23 年にかけて量産に入るイメージ。市場規模については、年間 2-3 億ドル程度を現状想定している。

Q: メモリと CPU 間のデータ転送が、半導体の低消費電力化、性能向上のボトルネックとなっている。この課題について御社から見て注目している半導体側の対応や、その先に想定されるテスト需要の恩恵についてコメントいただきたい。

A: ご指摘の通り、データ量が増加する中で、メモリと CPU 間のデータ伝送が現在ボトルネックになっている。それを受けて、プロセッシング・イン・メモリ(PIM)等の CPU とメモリが一体になっていくアプリケーションの提案や、CPU 単体やメモリ側の処理能力向上を図る動きが業界にある。例えばグラフィック用途で、GDDR6 等に PAM4 を組み込んだ高速転送技術が今後普及していくと考えている。これら技術の進化に伴って半導体テスト能力の向上が加速することで、将来テスト業界は恩恵を得ると期待している。

Q: 今後、北米ファウンドリーで半導体設備投資が増加する公算。その際、経済安全保障の観点でファウンドリー誘致が行われている以上、テストも米国製品を優先して採用する可能性があるが、この辺りのリスクをどう認識しているか。

A: 経済安全保障に関してのご質問ですが、例えばアメリカがアメリカでの生産回帰ということで、アメリカの技術だけで生産を行えるかというそうではなく、他の国の材料、装置を使って生産している。他地域との協力は必ずしもなくなるのではないかと。当社としては、情報収集、分析をきちんと行って対応する、そういう対応力を磨いていく。

- Q: 株主還元について確認したい。総還元性向 50%以上を基準とする一方で、株主還元額は 3 年間で 1,500 億円以上としている。当期純利益の 3 力年平均の上限は 700 億円であるので、上限で推移し続けた場合でも総還元性向は 50%をかなり上回る水準になる。50%としているのは配当性向であるか？
- A: 配当については、通期 100 円を基準とした固定的な金額をベースとし、徐々に増やしていきたいと思っている。それ以外の差額分は自社株買いの可能性がある。また、新中計での株主還元額 1,500 億円以上の想定の中には、純利益からのみならず、前中計期間中に生じた余剰キャッシュも株主還元の原資として含まれているため、総還元性向 50%を超える可能性はある。
- Q: 御社の「半導体の用途が広がったことでシクリカリティがなくなってきている」という見方は頷ける一方で、資本市場には中国スマートフォン市場の今後の調整懸念もある。また SPE 後工程の同業他社からも「市場のシクリカリティはなくなる」という声がある。足元の話で恐縮だが、半導体製造設備需要のシクリカリティについての御社の考えを改めて解説いただきたい。
- A: SPE 業界において、需要のアップダウンは今後もあり、大きく投資が進む良い時期があれば、そのあとの立ち止まりや後退もあり得る。今、半導体業界は足元活況であり、生産キャパシティ増強が行われているが、それが落ち着いたときにどうなるか、注意しておかないといけないと思っている。ただ、テスト市場は、Less-Cyclical な構造に変化していると当社は考えている。

以上

※本資料に記載されている内容は、新中期経営計画説明会の質疑をもとに当社の判断で要約したものです。また本資料には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。